

证券代码：601138

证券简称：工业富联

富士康工业互联网股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他						
参与单位名称	广发证券、华夏基金、建信基金、民生加银、新华资产、泰康资产、华泰资产、华安基金、华宝基金、东方红、国泰基金、平安资管、景顺长城、平安基金、望正资产、易方达、鹏华基金、招商基金、融通基金、P72、兴全基金、银华基金、广发基金、博时基金、南方基金、平安养老、交银施罗德、大成基金、摩根斯坦利、孝庸资产、国金证券						
时间	2026年5月15日 12:00-13:00、2026年5月18日 14:00-15:00						
地点	券商策略会、公司现场						
上市公司接待人员姓名	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">董事长&总经理</td> <td style="width: 50%;">郑弘孟</td> </tr> <tr> <td>副总经理</td> <td>何国樑</td> </tr> <tr> <td>证券事务代表</td> <td>揭晓小</td> </tr> </table>	董事长&总经理	郑弘孟	副总经理	何国樑	证券事务代表	揭晓小
董事长&总经理	郑弘孟						
副总经理	何国樑						
证券事务代表	揭晓小						
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1：市场高度关注公司下一代 AI 服务器平台的交付进展。请问公司 Vera Rubin 相关产品的量产节奏、供应链参与深度与价值量分布如何，市场传闻的延期是否属实？</p> <p>首先，关于市场关心的交付节奏，公司下一代平台并未出现延期，当前正按既定计划推进生产筹备与组装改样。从供应链地位看，公司在该平台核心环节的参与深度较上一代进一步提升，覆盖了交换机、计算托盘及中板等关键领域。</p> <p>第二，从产品价值量看，我们通常不就客户具体产品价值量进行评价。市场有一些研究数据，如据 NVIDIA 官方技术博客及 Tom's Hardware、DigiTimes 等消息，新一代 AI 整柜系统重量约 4,000 磅（约 1,800 公斤）。如果从自身角度而言，我们可以看到，整体产品复杂度与集成度较上一代均有显著扩大，包括像 PCB，也会看到高端的方案升级。</p> <p>Q2：公司当前 AI 服务器出货情况如何，全年展望怎样？下一代平台与当前产品之间如何衔接？</p> <p>首先，当前主力产品出货顺畅，为上半年增长奠定了坚实基础。</p> <p>第二，在下一代平台方面，已完成量产交付能力构建。</p> <p>第三，站在全年维度，AI 基础设施需求仍将保持高景气度的增长。据 TrendForce 预测，2026 年全球 AI 服务器出货量将同比增长逾 28%，公司核心产品将持续受益于行业红利，但行业需</p>						

求波动、市场竞争加剧及技术迭代等因素可能对行业发展带来不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

Q3: 公司在 AI 服务器零部件垂直整合方面有哪些最新进展？自供比例提升对获利结构将产生怎样的影响？

首先，公司持续强化 AI 全产业链垂直整合能力，当前已具备冷却系统、电源系统等关键零部件的自主生产能力。在服务器内部，相当高比例的零部件公司具备自制能力，目前自制比例仍有进一步提升空间。

第二，这些自主可控零部件的获利能力优于一般组装业务，随着自供比例提升，将为公司整体盈利质量带来结构性改善。同时，公司在稳步提升核心部件自供比例的同时，也会合理布局外部采购，通过产业链内外协同优化，保证供应链安全。

第三，在液冷方面，由于下一代系列产品对散热效率要求大幅提升，公司将努力持续提升液冷零组件自供比例。据 TrendForce 数据，全球 AI 数据中心的液冷渗透率将从 2024 年的 14% 迅速攀升至 2026 年的 40%。

Q4: CPO 全光交换机作为行业高度关注的技术方向，公司目前的产业化进展如何？如何看待 CPO 的市场空间与落地节奏？

首先，CPO 通过将交换器芯片与光引擎一起封装在载板上，缩短电光转换距离，实现大带宽、低时延、低功耗，有效解决传统铜连接的物理方案限制。公司对 CPO 在高速率时代的渗透率、应用边界持续关注，布局与产能和行业技术发展匹配。

第二，在产业化进展方面，公司 CPO 全光交换机样机已经启动生产，开始出货，在多个地区工厂同步布局产能，明年有望进一步扩张规模。据 YOLE 与 TrendForce 等预测，CPO 市场规模将从 2024 年的 0.46 亿美元增至 2025 年的 4.2 亿美元，2026 年突破 32 亿美元，预计 2030 年达 81 亿美元，2024-2030 年 CAGR 高达 137%。2026 年被行业视为 CPO 规模化商用元年，随着头部厂商产品落地，CPO 在高速交换机业务的竞争力将持续提升，但行业需求波动、市场竞争加剧及技术迭代等因素可能对行业发展带来不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

Q5: 公司在 ASIC 领域的客户合作与业务放量情况如何？如何看待 ASIC 服务器市场的增长确定性？

首先，行业层面，据 TrendForce 预测，伴随大型云服务商自研芯片提速，ASIC AI 服务器出货占比将从 2026 年的 27.8% 升至 2030 年的 39.5%，接近四成。ASIC 芯片的定制化属性极强，对供应链的响应速度、整合水平要求很高，这也为具备全链条布局优势的企业提供了差异化竞争机会。

第二，客户合作层面，公司与多个全球主要客户在 ASIC 领域已有非常深度的合作，依托对行业趋势的提前判断，提前在全球多个区域进行布局。但是若公司未来未能保持自身竞争优势，未

	<p>能持续通过技术迭代与产品创新满足日益丰富的客户需求，或将对公司订单获取、市场份额及经营收入增长节奏带来一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>第三，业务落地层面，公司一季度 AI ASIC 服务器出货量实现同比增长 3.2 倍。依托公司在全球多个厂区完整的产业链布局和客户信任，出货有望提升，效率与交付周期也会进一步改善。</p> <p>Q6：公司今年资本开支的重点方向是什么？在自动化、电力基础设施有什么布局，怎么看上游部分原材料紧缺及涨价情况？</p> <p>首先，公司今年资本开支重点投向产线智能化改造与电力基础设施升级，其中自动化设备占据重要比重。自动化产线的提升意味着同样的资本投入，产能释放更快、产品迭代更高效。</p> <p>第二，在电力基础设施方面，数据中心最大考验是电力供应，公司加强电力基础设施建设，新厂建设正从 400V 向 800V 高压架构升级，以提升能耗效率。</p> <p>第三，上游资源方面，大型 CSP 等客户的供应保障能力较强；预计未来几年部分关键资源仍可能阶段性趋紧，公司已通过战略备货等方式提前布局，保障生产连续性。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	